

ICS 31.030

L90

备案号:

SJ

中华人民共和国电子行业标准

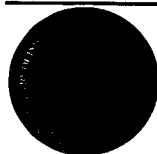
SJ/T 11389—2009

无铅焊接用助焊剂

Fluxes for lead-free soldering application

2009-11-17 发布

2010-01-01 实施



中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准由中华人民共和国工业和信息化部电子信息产品污染防治标准工作组提出。

本标准由中国电子技术标准化研究所归口。

本标准起草单位：深圳市唯特偶化工开发实业有限公司、北京金朝电子材料有限公司、工业和信息化部电子第五研究所、工业和信息化部专用材料质量监督检验中心、昆山成利焊锡制造有限公司、航天部北京国营第六六九厂。

本标准起草人：张鸣玲、杨嘉骥、谢成屏、何秀坤、苏明斌、丁飞。

引 言

根据《电子信息产品污染控制管理办法》（信息产业部第39令）的有关要求，落实“从源头抓起”的思路和原则，在产品的设计、生产过程中，通过改变研究设计方案，调整工艺流程，更换使用材料等技术措施从而达到电子信息产品污染控制的目的。因此，在电子信息产品生产中限制使用铅，要求电子组装联接使用无铅焊料。

无铅焊料与传统的锡铅焊料相比，性能上明显的差别是熔点高，润湿力差。为配合无铅焊料更好的使用，必须使用无铅焊料专用助焊剂，传统助焊剂的一些技术要求，有些不适合无铅焊接用助焊剂。为适应无铅焊接用助焊剂实际应用的需要，同时兼顾与国际相关标准的接轨，参考有关国际标准和工业界实践，特制定本标准。